



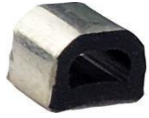
鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料及创新器件领军企业

【屏蔽材料规格书】

SMT导电泡棉系列



A 系列



B 系列

-产品图-

HFC-SMT 泡棉是一种可通过 SMT 回流焊接在 PCB 板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于 EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹性优越,耐高温,具有优良的导电性和抗氧化性,焊接强度较好,产品符合欧盟 ROHS 要求。在回流焊接时使用的焊料和锡接触很好,焊接后跟 PCB 板有很好的接触强度。

产品特点:

- ★ 低压缩率 (10%~20%) 下有良好的导电性能
- ★ 面接触方式,压缩力稳定,避免天线触点损坏
- ★ 可二次焊接使用
- ★ 占用面积小,增加天线净空面积
- ★ 较高的回弹性
- ★ 自动贴装

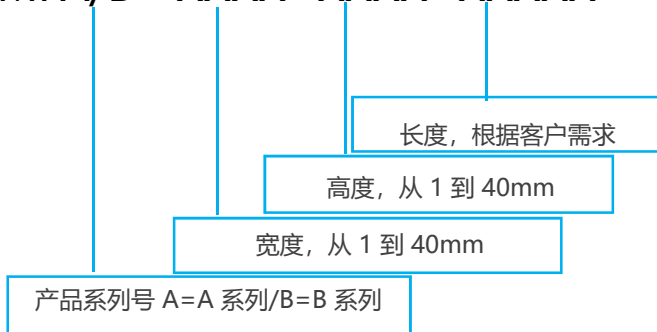
产品应用:

- ★ 射频接地 电磁干扰
- ★ 直流接地 消除静电
- ★ 射频互联 射频干扰屏蔽垫片
- ★ 外壳对印刷电路板接地
- ★ 元件对印刷电路板接地

产品规格:

料号说明:

SMFA/B - XXXX -XXXX -XXXXX



产品型号	尺寸 (mm)		
	W	H	L
SMFA-0400-0400-00300	4	4	3
SMFA-0400-0450-00500	4	4.5	5
SMFA-0300-0250-00200	3	2.5	2

(1) 其他尺寸可根据客户需求,长度可为任意,制程宽度:W≥2mm,高度:2mm≤H≤15mm。

(2) 产品公差: W/H/L<50mm, ±0.48mm; 50mm≤W/L<100mm, ±0.68mm W/L≥100mm, ±0.98mm。

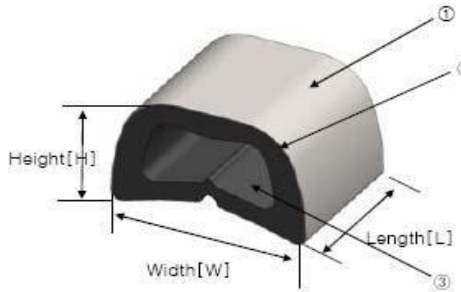
备注: 产品的形状结构,也可根据客户要求来进行设计。



鸿富诚

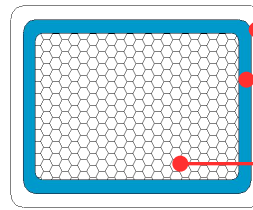
专业·专心·专注

创新功能材料及创新器件领军企业



A系列产品结构示意图

- ①PI膜-铜-锡
- ②粘接剂
- ③硅胶



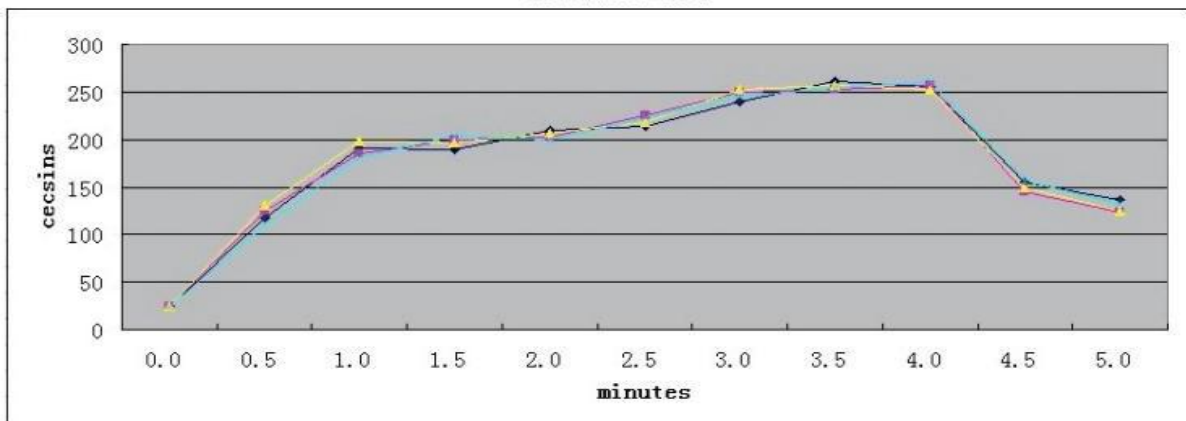
B系列产品结构示意图

性能参数:

材料名称	SMT 系列导电泡棉				测试标准
	SMFA 系列	SMFB 系列	SMFA 系列	SMFB 系列	
料号	SMFA 系列	SMFB 系列	SMFA 系列	SMFB 系列	/
材质	镀锡 PI		镀金 PI		/
颜色	银色		金色		目视
表面电阻 (Ω/inch^2)	≤ 0.05		≤ 0.03		ASTM F390
垂直电阻 (Ω)	≤ 0.05		≤ 0.03		ASTM F390
回复率 (%)	> 90				ASTM D3574
焊接强度 (gf/cm)	≥ 1500		> 1500		HFC测试
防火性能 UL	/	V-2	/	V-2	HFC测试
瞬间耐温 ($^{\circ}\text{C}$)	400				GBT 2423.2
长期工作温度 ($^{\circ}\text{C}$)	$-40 \sim +150$				GBT 2423.2

推荐加温图:

SMT波峰焊温控曲线图





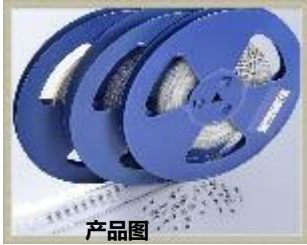
鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料及创新器件领军企业

产品包装:

产品图



产品图

真空包装



本产品采用先进的自动化封膜模式,产品封装在卷袋里,可避免在运输、储存过程中造成损坏。本产品包装设计方便运输,储存,又可保证产品的数量。每卷包装数量以整数计算,可分为1000pcs、1500pcs、2000pcs,每卷(或以客户要求为准),也可散装。本产品包装最大的优点是客人在组装时可以使用全自动及半自动流水线生产。

其它:

- ★常温下保存,避免日光直射,置于 $23^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$, $65\%\pm 5\%\text{RH}$ 的情况下,有效期 3 个月
- ★以上数据均为我司实际测试所得,最终解释权在我司实验室。
- ★若对本公司产品存有疑问,敬请联络本公司人员,以便更好的为您服务。